精选快讯　硬件快讯　2026年11月17日 19:06

集邦预估2027年AI ASIC出货翻倍且增速超GPU，整体AI服务器增三成

要点

- 研调机构集邦（TrendForce）最新报告预估，2027年AI特殊应用晶片（ASIC）出货量将实现翻倍，且成长动能有望延续至2028年，期间出货量与成长率将持续优于GPU。
- 尽管需求强劲，实际出货仍面临供应链瓶颈。
- 展望2028年，集邦对AI伺服器成长持保守态度，认为2027年下半年将是检验相关风险是否提前发酵的关键期。

研调机构集邦（TrendForce）最新报告预估，2027年AI特殊应用晶片（ASIC）出货量将实现翻倍，且成长动能有望延续至2028年，期间出货量与成长率将持续优于GPU。同期，整体AI伺服器出货预计年增三成。这一预测基于Google、亚马逊云端服务（AWS）等业者持续扩大自研ASIC布局，以及大陆业者因自主化需求加速采用本土AI晶片的趋势。

尽管需求强劲，实际出货仍面临供应链瓶颈。集邦指出，先进封装CoWoS、高带宽记忆体（HBM）及基板供给吃紧，加上AI机柜组装耗时，限制了交付速度。其中，HBM4预期于2027年成为主流。在资本支出方面，2027年云端服务供应商（CSP）支出仍可望续强，北美四大CSP最具韧性；而甲骨文（Oracle）、中小型新兴云端业者（Neocloud）及中国大陆CSP则面临较高的资本支出下修压力。

展望2028年，集邦对AI伺服器成长持保守态度，认为2027年下半年将是检验相关风险是否提前发酵的关键期。主要变数包括期中选举后各州监管趋严、供电瓶颈与许可递延，这些因素将成为2028年资料中心建置的重要挑战。

报道来源：wearn、udn

来源网站：https://www.inews.today/